

## 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第十七次会议、2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司提供担保额度、子公司之间互相提供担保额度总计不超过180,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过120,000万元。在上述额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。本次担保的适用期限为2023年年度股东大会审议通过后至2024年年度股东大会重新审议为子公司融资业务提供担保额度之前。

详情参见公司于2024年4月26日、2024年5月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-022）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-028）及相关公告。

### 二、担保进展情况

近日，公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司（以下简称“大为创芯”）与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）签订了《综合授信协议（编号：ZH39142409002）》《流动资金借款合同（编号：ZH39142409002-1JK）》，授信额度为人民币1,000万元，贷款金额为

人民币 100 万元，贷款期限为 2024 年 11 月 29 日至 2025 年 11 月 28 日；公司与光大银行深圳分行签订了《最高额保证合同（编号：GB39142409002）》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的主债权本金最高额为人民币 1,000 万元。

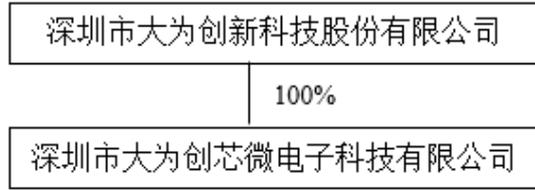
公司全资子公司深圳市芯汇群科技有限公司（以下简称“芯汇群科技”）与光大银行深圳分行签订了《综合授信协议（编号：ZH39142411001）》《流动资金借款合同（编号：ZH39142411001-1JK）》，授信额度为人民币 1,000 万元，贷款金额为人民币 100 万元，贷款期限为 2024 年 11 月 29 日至 2025 年 11 月 28 日；公司与光大银行深圳分行签订了《最高额保证合同（编号：GB39142411001）》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的主债权本金最高额为人民币 1,000 万元。

上述担保事项在公司第六届董事会第十七次会议、2023 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东大会审议。

### 三、被担保人基本情况

#### （一）深圳市大为创芯微电子科技有限公司

- 1.名称：深圳市大为创芯微电子科技有限公司
- 2.成立日期：2011 年 3 月 23 日
- 3.注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406
- 4.法定代表人：连浩臻
- 5.注册资本：3,000 万人民币
- 6.主营业务：半导体电子产品测试、晶圆测试，半导体电子产品的生产加工及销售（凭深福环批【2013】400019 号批复生产）；集成电路、混合集成电路、新型电子元器件、电力电子器件及软件的技术开发；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）。
- 7.股权结构图



8.与公司关系：深圳市大为创芯微电子科技有限公司为公司全资子公司。

9.主要财务指标：

单位：人民币元

项目名称	2024年9月30日财务状况（未经审计）	2023年12月31日财务状况（经审计）
资产总额	185,990,327.89	138,183,188.63
负债总额	140,355,784.81	94,526,391.72
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	45,634,543.08	43,656,796.91
项目名称	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	617,193,103.16	630,704,175.44
利润总额	3,419,796.16	-22,571,991.35
净利润	3,080,460.64	-25,525,469.69

10.深圳市大为创芯微电子科技有限公司不属于失信被执行人。

## （二）深圳市芯汇群科技有限公司

1.名称：深圳市芯汇群科技有限公司

2.成立日期：2021年5月11日

3.注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

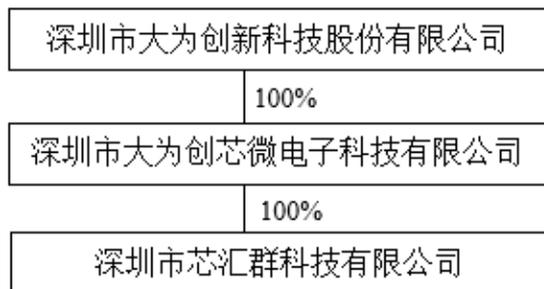
4.法定代表人：连浩臻

5.注册资本：100万人民币

6.主营业务：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电子产品、电子元器件、光电产品、数码产品、科技产品、通讯产品、网络设备、计算机软硬件的技术开发与销售；经营电子商务，国内贸易。商务信息咨询、信息系统集成、电子计算机配件（固

态硬盘、移动固态硬盘、内存条、U盘)的销售。

#### 7.股权结构图



8.与公司关系：深圳市芯汇群科技有限公司为公司全资孙公司。

#### 9.主要财务指标：

单位：人民币元

项目名称	2024年9月30日财务状况（未经审计）	2023年12月31日财务状况（经审计）
资产总额	73,445,278.87	20,583,554.31
负债总额	71,327,900.78	19,024,203.71
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	2,117,378.09	1,559,350.60
项目名称	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	232,129,557.32	106,427,405.73
利润总额	558,575.93	-3,202,233.78
净利润	547,427.49	-3,046,561.37

10.深圳市芯汇群科技有限公司不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

（一）公司与光大银行深圳分行签订的《最高额保证合同（编号：GB39142409002）》主要内容

- 1.保证人：深圳市大为创新科技股份有限公司
- 2.债权人：中国光大银行股份有限公司深圳分行
- 3.被担保的债务人：深圳市大为创芯微电子科技有限公司
- 4.保证方式：连带责任保证

5.担保范围：大为创芯在《综合授信协议（编号：ZH39142409002）》《流动资金借款合同（编号：ZH39142409002-1JK）》项下应向光大银行深圳分行偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。

6.保证期间：《综合授信协议（编号：ZH39142409002）》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

（二）公司与光大银行深圳分行签订的《最高额保证合同（编号：GB39142411001）》主要内容

- 1.保证人：深圳市大为创新科技股份有限公司
- 2.债权人：中国光大银行股份有限公司深圳分行
- 3.被担保的债务人：深圳市芯汇群科技有限公司
- 4.保证方式：连带责任保证

5.担保范围：芯汇群科技在《综合授信协议（编号：ZH39142411001）》《流动资金借款合同（编号：ZH39142411001-1JK）》项下应向光大银行深圳分行偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。

6.保证期间：《综合授信协议（编号：ZH39142411001）》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具

体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

(三) 大为创芯、芯汇群科技均为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情形。

## 五、累计担保数量及逾期担保的数量

公司对合并报表范围内的子公司提供担保、子公司之间互相提供担保的额度为总计不超过 180,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 120,000 万元。

截至本公告日，公司及子公司无对外担保的情形，扣除已履行到期的担保，公司为子公司提供担保的总金额为 1,850 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.05%，公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保额度总余额为 178,150 万元；其中，向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保金额为 850 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.40%，向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度余额为 119,150 万元。

公司全资子公司大为创芯向招商银行股份有限公司深圳分行借款 500 万元，深圳市中小企业融资担保有限公司为上述借款提供连带责任保证，公司已为上述担保提供反担保。除此之外，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，对应担保额度及余额均为 0；公司及子公司无逾期债务情形，对应的担保额度及余额均为 0；无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保情形，对应的担保金额为 0。

## 六、备查文件

(一) 大为创芯、芯汇群科技分别与光大银行深圳分行签订的《综合授信协议》《流动资金借款合同》、公司与光大银行深圳分行签订的《最高额保证合同》；

(二) 公司子公司近期归还银行借款的回执文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 2 日